

Presse À Chaud Intégrée 24 Tonnes, Plateaux De 200X200 Mm Pour La Préparation D'échantillons En Laboratoire

Numéro d'article: XP55



Introduction

Presse à chaud intégrée professionnelle avec une force de serrage de 24 tonnes et des plateaux chauffants de 200x200 mm, idéale pour la recherche sur les batteries, les essais de matériaux et la préparation d'échantillons. Le contrôle précis de la température jusqu'à 300°C garantit des résultats fiables et reproductibles.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Pressage d'électrodes et d'électrolytes pour batteries	Consolidation de poudres de cathode/anode et fabrication de pastilles d'électrolyte solide pour les cellules lithium-ion et les batteries de nouvelle génération.	Une distribution uniforme de la densité évite les points chauds et garantit une conductivité ionique constante sur toute la pastille.
Estampage et laminage de films polymères	Collage thermique de films polymères multicouches, scellement de puces microfluidiques et texturation de surface pour les dispositifs laboratoire-sur-puce.	Le contrôle précis de la température et de la pression préserve les nanostructures délicates sans dégradation thermique.
Préparation de pastilles pour IRTF et XRF	Fabrication de pastilles de KBr transparentes pour la spectroscopie infrarouge et de perles fusionnées pour l'analyse par fluorescence X.	Élimine les inclusions d'air et les variations d'épaisseur, pour des lignes de base spectrales reproductibles.
Développement de matériaux composites	Pressage à chaud de composites à matrice métallique, de polymères renforcés de céramique et consolidation de pré-imprégnés de fibre de carbone.	Maximise l'imprégnation des fibres et l'élimination des vides sous des profils contrôlés de température et de pression.
Production pilote de comprimés pharmaceutiques	Compression de petits lots de mélanges de poudres en comprimés pour les essais de formulation et les études de stabilité.	L'enregistrement complet des paramètres de pressage facilite la documentation FDA/EMA et les études de mise à l'échelle.
Frittage en métallurgie des poudres	Pré-compaction de poudres métalliques et céramiques à température élevée avant le frittage final.	Augmente la densité verte et réduit le retrait au frittage, améliorant la précision de forme finale.
Collage de plaquettes semiconductrices	Collage par compression thermique de plaquettes de silicium ou d'assemblages puce-sur-flexible avec force et température contrôlées.	Obtient des lignes de collage uniformes sans vides, un point critique pour la fabrication de systèmes microélectromécaniques (MEMS).

Paramètre	XP55
Modèle	XP55
Capacité de presse	0 - 24 tonnes
Température de travail des plateaux	Ambiante - 300 °C
Puissance de chauffe (totale)	1200 W (2 x 600 W)
Dimensions des plateaux	200 x 200 mm
Refroidissement des plateaux	Circulation d'eau intégrée
Régulation de température	PID bi-zone avec stabilité de ±2 °C
Affichage et commande	Écran tactile 4,3 pouces, programmable
Alimentation électrique	220 V, 50 Hz, monophasé
Dimensions globales (L x P x H)	950 x 260 x 525 mm

Paramètre	XP55
Poids net	180 kg